



# Press Release

日本ケミコン株式会社

2010年4月28日

## 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサのSPICEモデル公開

### 技術支援ツールページを開設

このたび日本ケミコンは、チップ形の導電性高分子アルミ固体電解コンデンサを対象に、シミュレーションソフトウェアで使用可能なデバイスモデル（SPICEモデル）を公式社外ホームページで公開いたしました。巻回形のコンデンサでは、業界に先駆けた取り組みとなります。

電子回路設計の効率化を目的に、回路シミュレーションを用いた製品設計が進んでいます。基板を試作する以前に回路動作の挙動を確認することが可能となるため、設計期間の短縮やコスト削減、さらには設計段階からの品質確保につながっています。

より実測に近いシミュレーションを行うためには、取り扱う電子部品の精度の高いモデルが必要となります。アルミ電解コンデンサでは、ESRやESLなどの寄生成分が回路動作に影響するため、これらの成分を十分に反映させたモデルへのニーズが高まっています。

このたび公開したチップ形の導電性高分子アルミ固体電解コンデンサのSPICEモデルは、これらの寄生成分を考慮したモデルといたしました。特定の周波数帯域におけるESRの変化や容量変化の影響を反映させることが可能となり、より精度の高い回路シミュレーションに貢献いたします。

今後はリード形の導電性高分子アルミ固体電解コンデンサなど、対象となる製品ラインアップの拡充を図ってまいります。

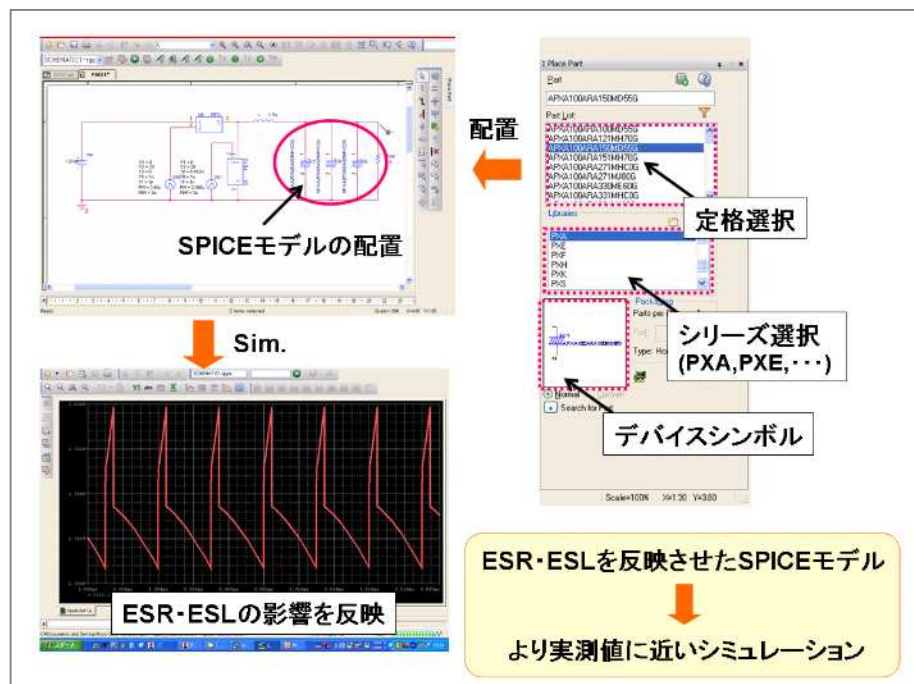
### 《HP情報》

「技術支援ツール | SPICEモデル・等価回路モデル」:

(日本語) [http://www.chemi-con.co.jp/tech\\_tools/index.html](http://www.chemi-con.co.jp/tech_tools/index.html)

(英語) [http://www.chemi-con.co.jp/e/tech\\_tools/index.html](http://www.chemi-con.co.jp/e/tech_tools/index.html)

## 《シミュレーションイメージ》



## 《サイトイメージ》



以上